

2018年11月26日

各位

J A三井リース株式会社

SEMICON Japan2018 出展のお知らせ

当社は半導体製造装置・材料の国際展示会である「SEMICON Japan2018」に出展しますので、下記の通りお知らせいたします。

記

日時	2018年12月12日(水)～14日(金) 各日 10:00-17:00
会場	東京都江東区有明 3-10-1 東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟 (当社出展ブース：1ホール 1645)
主催	SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)
公式サイト	http://www.semiconjapan.org/jp/ (公式サイト内の当社ページ)

SEMICON Japan は今年で 42 回目の開催となる半導体製造装置・材料分野における世界最大級の総合イベントです。半導体関連デバイスの製造に関わる製品・技術・サービスの全てを網羅する国内唯一の国際展示会となります。

当社はこれまで国内外のお客様に対し数多くの大型案件を組成、半導体製造装置のリース・ファイナンス分野で世界有数の取組実績を有しております。また、2015年7月に半導体企業が密集する台湾の新竹に営業所を立ち上げ、2016年10月には米国シリコンバレーに当社米国法人の支店を開設いたしました。

SEMICON Japan では、当社の出資先である AG Semiconductor Services, LLC 社と共同でグローバルに展開するリース・ファイナンス事業、及び中古半導体製造装置売買事業をご紹介します(当社エレクトロニクス分野取組概要は[こちら](#)をご覧ください)。

是非ご来場ください。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

グローバル営業本部 グローバルエレクトロニクス部
(担当：森松、三澤 電話：03-6775-3045)